**华南理工大学2022-2023年度“金发科技奖学金”申请表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 学 历 |  | 学 号 |  | 相片 |
| 性 别 |  | 民 族 |  | 籍 贯 |  |
| 政治面貌 |  | 出生年月 |  |
| 英语等级 |  | 成绩排名 |  |
| 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| 学 院 |  | 导师姓名 |  |
| 家庭住址 |  | 特长及爱好 |  |
| **教育情况（本科及以上）** |
| 时间（起止） | 学校 | 专业 | 学历 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **家庭情况** |
| 与本人关系 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 担任职位 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **学生工作情况** |  |
| **学生活动** |  |
| **实习情况** |  |
| **专利、论文** |  |
| **个人评价** |  |
| **对金发科技的认识** |  |
| **对“金发科技奖学金”的设立形式、奖励方式等的看法、建议及宝贵意见** |  |
| **学院评审意见** |  签字（盖章） 年 月 日 |
| **学校评审意见** |  签字（盖章） 年 月 日 |
| **公司评审意见** |  签字（盖章） 年 月 日 |